

SBCP56系列

NPN硅 外延晶体管

这些NPN硅外延晶体管设计用于使用音频放大器应用。该设备被容纳在SOT-223包，它是专为中功率的表面贴装应用程序。

特点

- 高电流：1.0
- 采用SOT-223封装可以焊接使用波或回流。该焊接过程中形成的线索吸收热应力，消除了损坏模具的可能性
- 采用12毫米磁带和卷轴
 - 使用BCP56T1责令7英寸/1000单元卷轴
 - 使用BCP56T3订购13英寸/4000单元卷轴
- PNP补是BCP53T1
- AEC-Q101标准，并有能力PPAP
- S前缀为汽车和独特需要其他应用程序站点和控制变化的要求
- 这些器件是无铅，无卤素/无溴化阻燃剂和符合RoHS柔顺

最大额定值

($T_C = 25^\circ\text{C}$ 除非另有说明)

等级	符号	价值	单位
集电极-发射极电压	$V_{CE(sat)}$	80	VDC
集电极-基极电压	V_{CBO}	100	VDC
发射极-基极电压	V_{EBO}	5	VDC
集电极电流	I_C	1	ADC
总功耗 @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ (注1) 避免上述 25°C	P_T	1.5 12	W 毫瓦/ $^\circ\text{C}$ 的
工作和存储 温度范围	T_J, T_{stg}	-65 150	$^\circ\text{C}$

热特性

特征	符号	最大	单位
热阻， 结到环境 (表面贴装)	$R_{\theta JA}$	83.3	$^\circ\text{C}/\text{W}$
最高温度 焊接用途 在焊接洗澡时间	T_L	260 10	$^\circ\text{C}$ 美国证券交易委员会

请勿超过最大额定值可能会损坏设备。最大额定值的压力额定值只。以上推荐的功能操作工作条件不足暗示。长时间暴露在上面的压力推荐的工作条件可能会影响器件的可靠性。

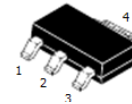
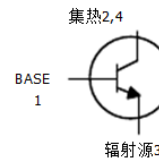
1. 装置安装在FR-4玻璃环氧印刷电路板的1.575英寸x1.575英寸x0.0625的; 安装焊盘的集电极引线= 0.93平方英寸



ON Semiconductor®

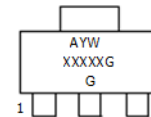
<http://onsemi.com>

中功率NPN硅 高电流晶体管 表面贴装



SOT-223
CASE 318E
风格1

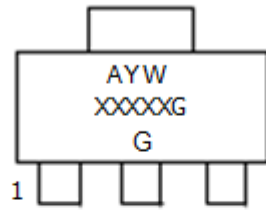
标记图



- xx = 具体设备守则
- A = 大会地点
- Y = 年
- W = 工作周
- G = Pb-Free 包装
(注：徽球可在任一位置)

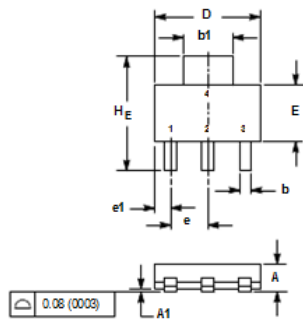
订购信息

请参阅包装详细的订购和发货信息
尺寸部分本数据手册的第2页。



- xx = 具体设备守则
 - A = 大会地点
 - Y = 年
 - W = 工作周
 - G = Pb-Free包装
- (注：微球可在任一位置)

SOT-223 (TO-261)
CASE 318E -04
ISSUE #



注：所有尺寸均以公制为准，除非另有说明。
1. 尺寸和公差符合MIL-STD-203, 1994年。
2. 控制尺寸，英寸。

符号	MILLIMETERS			INCHES		
	标	准	最大	标	准	最大
A	1.90	1.63	1.75	0.060	0.064	0.069
A1	0.02	0.06	0.10	0.001	0.002	0.004
b	0.60	0.73	0.89	0.024	0.030	0.035
bf	2.90	3.06	3.20	0.114	0.121	0.126
ø	0.24	0.28	0.35	0.009	0.011	0.014
ø	6.30	6.50	6.70	0.248	0.256	0.264
e	3.30	3.50	3.70	0.130	0.138	0.146
e	2.30	2.30	2.40	0.091	0.091	0.094
e1	0.83	0.94	1.03	0.033	0.037	0.041
L	0.20	---	---	0.008	---	---
L1	1.90	1.75	2.00	0.060	0.069	0.079
He	6.70	7.00	7.30	0.264	0.276	0.287
q	---	---	10*	---	---	10*

- 规格 1:
PIN 1 - BASE
2 - 元件端
3 - 元件端
4 - 元件端

焊接足迹*

